

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-281268

(43)Date of publication of application : 10.10.2001

(51)Int.Cl.

G01R 1/073

G01R 31/26

H01L 21/66

(21)Application number : 2000-307609

(71)Applicant : TOKYO ELECTRON LTD

(22)Date of filing : 06.10.2000

(72)Inventor : TAKEKOSHI KIYOSHI

HOSAKA HISATOMI

(30)Priority

Priority number : 2000013741

Priority date : 24.01.2000

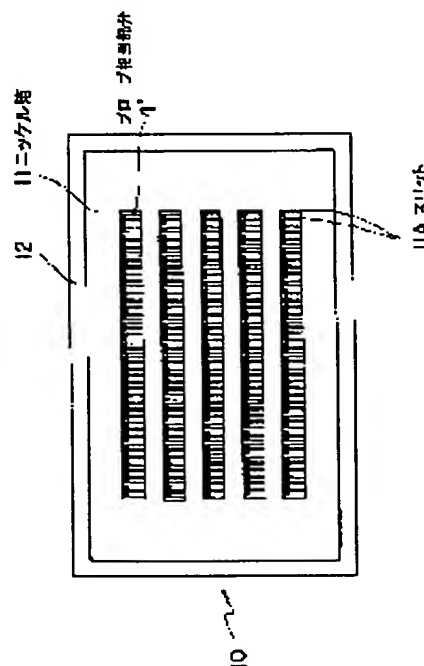
Priority country : JP

(54) PRODUCTION METHOD AND MOUNTING METHOD AND APPARATUS FOR PROBE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent increase in cost of a probe card because of the need for a plurality of photomasks even when one type of probe card is produced in the production of the probe cards using a lithography technique.

SOLUTION: In the production method of a probe, there are arranged a process in which slits 11A arrayed in a matrix are formed on a nickel foil 11 while support equivalent parts 4'B each formed between the slits 11A are formed being separable at both ends thereof, a process in which contact equivalent parts 4'A are produced being arrayed in a matrix on a silicon substrate 17 corresponding to each of end parts of the support equivalent parts 4'B formed on the nickel foil 11 and a process in which the contact equivalent parts 4'A on the silicon substrate 17 are transferred onto the support equivalent parts 4'B formed on the nickel foil 11 in a package.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-281268

(P 2001-281268A)

(43) 公開日 平成13年10月10日 (2001. 10. 10)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	F I	ターマコード (参考)
G01R 1/073		G01R 1/073	F 2G003
31/26		31/26	J 2G011
H01L 21/66		H01L 21/66	B 4M106

審査請求 未請求 請求項の数16 O L (全13頁)

(21) 出願番号 特願2000-307609 (P 2000-307609)
(22) 出願日 平成12年10月 6 日 (2000. 10. 6)
(31) 優先権主張番号 特願2000-13741 (P 2000-13741)
(32) 優先日 平成12年 1 月24日 (2000. 1. 24)
(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000219967
東京エレクトロン株式会社
東京都港区赤坂 5 丁目 3 番 6 号
(72) 発明者 竹腰 清
山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の 1
東京エレクトロン山梨株式会社内
(72) 発明者 保坂 久富
山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の 1
東京エレクトロン山梨株式会社内
(74) 代理人 100096910
弁理士 小原 肇

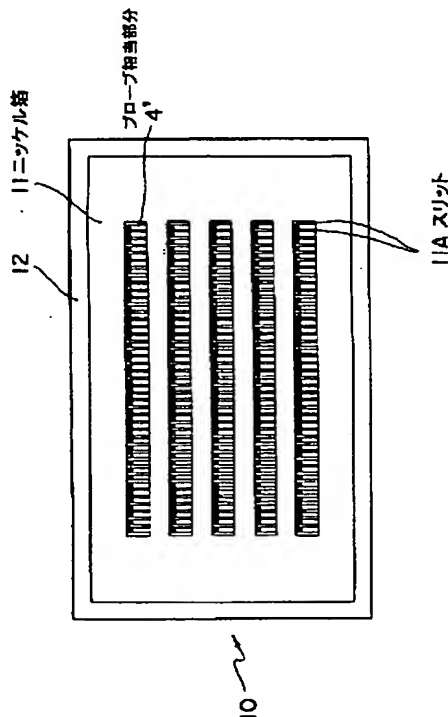
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 プローブの製造方法並びにプローブの取付方法及びプローブの取付装置

(57) 【要約】

【課題】 リソグラフィ技術を用いてプローブカードを製造する場合には、一種類のプローブカードを作製するにも複数枚のフォトマスクが必要になり、プローブカードのコスト高を招く。

【解決手段】 本発明のプローブの製造方法は、ニッケル箔 11 にマトリックス状に配列したスリット 11 A を形成し且つ各スリット 11 A 間に形成された支持体相当部分 4' B をその両端で切り離し可能に形成する工程と、ニッケル箔 11 に形成された各支持体相当部分 4' B の一端部それぞれに対応させて接触子相当部分 4' A をシリコン基板 17 にマトリックス状に配列して作り込む工程と、ニッケル箔 11 に形成された支持体相当部分 4' B にシリコン基板 17 の接触子相当部分 4' A を一括して転写する工程とを備えている。



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-153748

(43) 公開日 平成8年(1996)6月11日

(51) Int. Cl. ⁶

H01L 21/60

識別記号

311

庁内整理番号

R 7726-4E

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 1 F D (全4頁)

(21) 出願番号 特願平6-314283

(22) 出願日 平成6年(1994)11月25日

(71) 出願人 000146722

株式会社新川

東京都武蔵村山市伊奈平2丁目51番地の1

(72) 発明者 木村 一正

東京都武蔵村山市伊奈平2丁目51番地の1

株式会社新川内

(72) 発明者 鈴木 康志

東京都武蔵村山市伊奈平2丁目51番地の1

株式会社新川内

(74) 代理人 弁理士 田辺 良徳

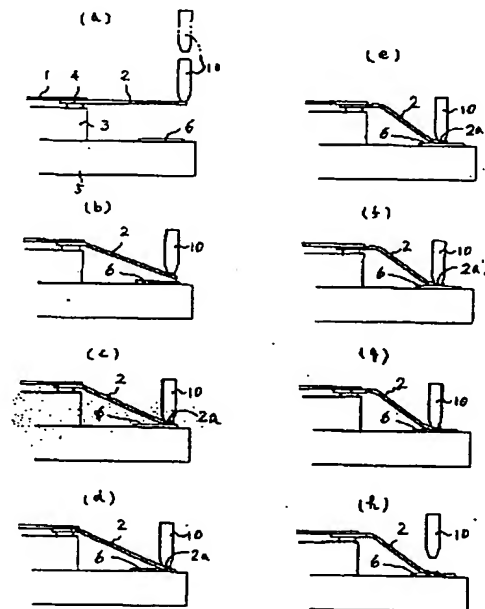
(54) 【発明の名称】 シングルポイントボンディング方法

(57) 【要約】

【目的】 応力を吸収できる形状にリードをボンディングする。

【構成】 リード2の自由端部にツール10により圧痕2aを付け、この圧痕2aの凹凸部にツール10を引っ掛けてリード2の固定端方向にツール10を移動させた後、リード2をパッド6にボンディングして接続する。

【効果】 成型型を使用しなく、また別工程で行う必要がなく、コストダウンが図れる。



1: ツール
2: リード
2a: 圧痕
3: チップ
4: パッド
5: 固定基板
6: パッド
10: ツール